

高导热高导电大功率银胶KM1912HK美国进口

产品名称	高导热高导电大功率银胶KM1912HK美国进口
公司名称	东莞市弘泰电子有限公司
价格	3750.00/瓶
规格参数	品牌:KMARKED 型号:KM1912HK 导热系数:60W/moK
公司地址	广东省东莞市樟木头镇怡乐花园2座27C
联系电话	0769-87795324 13356465858

产品详情

一. 产品描述

k m1912 h k 是一种具有高导电高导热性的固晶胶，单组份，粘度适中，低温储存时间长，操作方便。它是一种专门为细小的部件和类似于大功率led 粘接固定芯片应用而开发设计的新产品。该产品对分配和粘接大量部件时具有较长时间的防挥发、耐干涸能力，并可防止树脂在加工前飞溅溢出。

k m1912 h k 系列需要干冰运输。

二. 产品特点

具有高导热性：高达 60w/m-k

开启时间3到5小时

替换焊接剂 - 消除了铅 (pb) 金属与电镀要求

电阻率低至 4.0 μ .cm

低温下运输与储存 - 需要干冰

对调配与/或丝网印刷具有优良的流动性

极微的渗漏

三．产品应用

此银胶推荐应用在大功率设备上，例如：

大功率 led 芯片封装

功率型半导体

激光二极管

混合动力

rf 无线功率器件

砷化镓器件

单片微波集成电路

替换焊料

四．典型特性

物理属性：

25 粘度，kcps 千周(秒) @10 rpm(每分钟转数)，
#度盘式粘度计: 30

触变指数，10/50 rpm@25 :2.2

保质期：-15 保 6 个月, -40 保 12 个月

银重量百分比: 92%

银固化重量百分比: 97%

密度，5.7g/cc

加工属性(1)：

电阻率：4 μ .cm

粘附力/平方英寸(2)：2700

热传导系数，60w/mok

热膨胀系数，22.5ppm/ *

弯曲模量, psi 5800*

离子杂质：na+,cl-,k+,f-, ppm <12

硬度 8 0

冲击强度 大于 1 0 k g / 5 0 0 0 p s i

瞬间高温 2 6 0

分解温度 3 8 0

五．储存与操作

此粘剂可装在瓶子里须干冰。当收到物品后，-15 下储存在 1 - 5rpm 的罐滚筒里最佳。未能充分摇晃将导致非均匀性与不一致的调配。若没有摇晃，在使用前宜慢慢搅动。须冷冻储存。如果粘剂是均匀的（即在顶部没有溶解或在瓶子底部无粘稠固体），可以立即倒入针筒（灌注器）里使用。本产品同样也可包装在针筒里，且可以在负 40 度温度下运输。更多信息请参考“粘剂的针筒包装”文件。

六．加工说明

应用 km1912hk 的流动性通过利用自动高速流

动设备而无拉尾与滴落现象产生。在使用前应无气泡产生，在材料应用与组件放置期间能提供几个小时的开启时间。这对用在小组件当中很重要。推荐用 22 号针头（16 密耳）调配 km1912hk。

而小于 25 号（10 密耳）的针头可能不能产生一致的调配重量。

对于较大的晶片应把粘剂调配成 x 形状。按照部件的大小沉积重量可能有所不同。典型的调配数量是粘接面积的每平方英寸 75 微升或

290 毫克。晶片应与粘剂 km1912hk 完全按压，在围绕周边形成

银胶围高，使得湿沉积有 1.3 至 1.9 密耳的厚度，最终固化银胶

厚度应接近在 0.8 至 1.2 个密耳间。

七．固化介绍

对于较小的粘接面积（小于 0.250 英寸），无需预烘烤。较大的粘接部位需要在固化循环前进行预干燥。把材料放置在简易通风的地方，

在室温下利用空气强制对流，并设置所要的温度，如果使用带式炉或

其它类型的烤箱，升温率应当控制在理想的结果内。以下为升温率，

时间与温度的推荐值适合小于 0.4 英寸方形面积（10mm）的部件，

相关值见下表：粘接面积 > 0.250 - 0.400 英寸的预烤（如适用可选择

以下的其中一种方式）

峰值温度	升温率	烘烤时间
100 度	5 - 10 度/每分钟	75 分钟
110 度	5 - 10 度/每分钟	60 分钟
125 度	5 - 10 度/每分钟	30 分钟

粘接面积 0.4 尺寸的固化（可选择以下的其中一种方式）

峰值温度	升温率	固化时间
175 度	5 - 10 度/每分钟	45 分钟
200 度	5 - 10 度/每分钟	30 分钟
225 度	5 - 10 度/每分钟	15 分钟

东莞市弘泰电子有限公司www.gddght.cn 严再思 13356465858,13922910212 qq910907155